

CNET Japan (Japan)

Global market for 3D semiconductor packaging – November 28, 2023

CNET Japan > リリース

3D半導体パッケージングの世界市場

株式会社グローバルインフォメーション 2023年11月29日 09時00分 [[株式会社グローバルインフォメーションのプレスリリース一覧](#)]

大日本印刷が内部情報漏えい対策ソフトウェア「CWAT」を選んだ理由
導入事例、製品情報、調査・レポートなど、ホワイトペーパー多数掲載

株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、代表者：樋口 荘祐、証券コード：東証スタンダード 4171）は、市場調査レポート「3D半導体パッケージングの世界市場」（Global Industry Analysts, Inc.）の販売を11月28日より開始いたしました。

【当レポートの詳細目次】

[リンク](#)

3D半導体パッケージングの世界市場は2030年までに270億米ドルに達する

変化したCOVID-19後のビジネス環境において、2022年に82億米ドルと推計された3D半導体パッケージングの世界市場規模は、2030年には270億米ドルに達すると予測され、分析期間2022-2030年のCAGRは16.1%で成長すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つである貫通電極（TSV）は、CAGR 18.8%を記録し、分析期間終了時には147億米ドルに達すると予測されています。現在進行中のパンデミック後の回復を考慮し、パッケージ・オン・パッケージ分野の成長は今後8年間のCAGRを15.2%に修正しました。

米国市場は13億米ドル、中国はCAGR 20.1%で成長すると予測

米国の3D半導体パッケージング市場は、2022年には13億米ドルになると推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2022年から2030年までの分析期間においてCAGR 20.1%で推移し、2030年までに97億米ドルの市場規模に達すると予測されています。その他の注目すべき地理的市場としては、日本とカナダがあり、2022年から2030年にかけてそれぞれ11.3%と11.7%の成長が予測されています。欧州では、ドイツがCAGR約15%で成長すると予測されています。

調査対象企業の例

・IBM Corporation

- 3M Company
- Intel Corporation
- Advanced Micro Devices, Inc.
- Applied Materials, Inc.
- Amkor Technology, Inc.
- Cadence Design Systems, Inc.
- Globalfoundries, Inc.
- Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd.
- ASE Technology Holding Co., Ltd.
- AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG
- 3D PLUS SA
- LPKF Laser & Electronics AG
- China Wafer Level CSP Co., Ltd.
- EV Group Europe & Asia/Pacific GmbH

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 市場分析

第4章 競合

【無料サンプル】

[リンク](#)

【本件に関するお問い合わせ先】

<アジア最大の市場調査レポート販売代理店>

株式会社グローバルインフォメーション

マーケティング部

お問い合わせフォーム：[リンク](#)

TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）

URL：[リンク](#)

【会社概要】

1995年の創立以来、海外市場調査レポートの販売を通じて企業のグローバル展開を支援しています。世界5カ国に拠点を持ち、海外の提携調査会社200社以上が発行する調査資料約15万点をワンストップでご提供。市場情報販売のグローバル・リーディングカンパニーを目指し、企業ならびに社会の発展に寄与すべく、お客様にとって真に価値ある情報をお届けしています。

創立：1995年

所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F

事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託

市場調査レポート／年間契約型情報サービス：[リンク](#)

委託調査：[リンク](#)

国際会議：[リンク](#)

当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。

関連情報

<https://www.gii.co.jp/report/go1335277-3d-semiconductor-packaging.html>

本プレスリリースは発表元企業よりご投稿いただいた情報を掲載しております。

お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。

<https://japan.cnet.com/release/30920403/>